

电子元器件系统级组装及研发制造基地项目防腐地坪工程 II 标段(重新招标) 中
标公示

(招标编号: JX2023ZB-G012)

一、中标人信息:

标段(包)[001]电子元器件系统级组装及研发制造基地项目防腐地坪工程 II 标段(重新招
标):

中标人: 深圳市博大建设集团有限公司 中标价格: 435.935350 万元

二、其他:

受采购单位的委托, 我司对电子元器件系统级组装及研发制造基地项目防腐地坪工程 II
标段(重新招标)(项目编号: JX2023ZB-G012)进行了公开招标, 经评标委员会评审及采购
单位确认, 将中标结果进行公示:

中标单位: 深圳市博大建设集团有限公司

中标金额: 人民币肆佰叁拾伍万玖仟叁佰伍拾叁元伍角 (¥4,359,353.50)

为体现“公开、公平、公正”的原则, 现对以上中标结果公示三日。招标机构联系人: 杨工;
联系电话: 0755-82531482。

深圳市建星项目管理顾问有限公司

2023年7月11日

三、监督部门

本招标项目的监督部门为深南电路股份有限公司。

四、联系方式

招 标 人: 深南电路股份有限公司

地 址: 深圳市龙岗区

联 系 人: 王工

电 话: 19952231571

电子邮件：594098761@qq.com

招标代理机构：深圳市建星项目管理顾问有限公司

地 址：深圳市福田区振兴路3号建艺大厦16楼东

联 系 人：杨林明

电 话：83785193 转 836

电子邮件：353674985@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）